

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2023-098

## 天津普林电路股份有限公司

### 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2023年12月1日召开，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行申请并购贷款的议案》，具体情况如下：

#### 一、并购贷款情况概述

公司分别于2023年5月23日、2023年9月28日、2023年10月17日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》等议案，公司支付现金购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司（以下简称“TCL数码”）持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“泰和电路”、“标的公司”）1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴泰和电路新增注册资本5,693.8776万元。泰和电路已于2023年11月8日就本次交易完成了工商变更登记，公司已取得标的公司51%的股权。

为保障公司经营发展的资金需求，公司拟以持有的泰和电路的51%股权质押，向中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行申请并购贷款不超过2.5亿元，贷款期限7年，用于向TCL数码支付股权转让价款及对泰和电路进行增资，贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、质押标的公司基本情况

1、名称：泰和电路科技（惠州）有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册资本：14693.8776万元人民币

4、住所：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区

5、法定代表人：易剑平

6、成立日期：2009年12月17日

7、经营范围：高精单面、多层电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板、表面贴装加工、电子零配件、电子耗材、电子产品、机器零配件、五金零配件的研发、制造、加工及销售，货物及技术进出口，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司。

## 三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，符合公司长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

## 四、独立董事意见

公司以持有的泰和电路的 51% 股权作为质押，向银行申请并购贷款不超过 2.5 亿元，有利于提高公司资金使用效率，促进公司更好地发展，且履行了必要的审议决策程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次以股权质押申请并购贷款事项。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月一日